

证券代码：002916

证券简称：深南电路

## 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-17

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	天风证券策略会
时间	2021年12月8日
地点	策略会举办地（深圳）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司封装基板业务布局以及产品定位。</b></p> <p>公司目前现有深圳 2 家、无锡 1 家封装基板工厂，其中深圳封装基板工厂主要面向模组类封装基板产品；无锡封装基板工厂主要面向存储类封装基板，且具备 FC-CSP 产品技术能力。广州封装基板项目主要面向 FC-BGA 封装基板、RF 封装基板及 FC-CSP 封装基板产品。目前公司现有工厂已具备 RF 封装基板与 FC-CSP 封装基板的批量生产能力，FC-BGA 封装基板技术将在现有平台基础上进行深度孵化，公司目前已投入对 FC-BGA 封装基板产品技术的研发。</p> <p><b>Q2、请介绍公司无锡封装基板工厂产能爬坡进展。</b></p> <p>公司无锡封装基板工厂产能爬坡进展顺利，目前产能利用率已达 90%以上。此外，公司无锡高阶倒装芯片用封装基板项目当前正在进行前期基础工程建设。</p>

**Q3、请介绍 PCB 企业向封装基板领域拓展所需克服的主要壁垒。**

封装基板作为 PCB 的高端技术延伸，因其直接与芯片相连接，产品尺寸较小，精密程度较高，在线路精细、孔距大小和抗信号干扰等方面要求更高，存在较高的技术壁垒；另一方面，半导体产业链客户对封装基板制造厂商在产品生产、质量管控等运营层面能力的要求较高，企业需构建与半导体产业链相适应的运营体系。

**Q4、请介绍公司 PCB 业务各下游领域营收占比情况。**

公司 PCB 业务营收以通信领域为主，数据中心、汽车电子领域营收占比持续提升，工控医疗领域保持稳定发展。

**Q5、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域的发展情况。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一，公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，目前汽车电子业务占比较小，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品。与传统汽车电子产品相比，新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。未来伴随车联网等终端应用的涌现，汽车也可能成为新型的移动终端，公司在通信领域的技术优势可进一步延伸。

**Q6、请介绍公司汽车电子业务主要客户类型。**

公司汽车电子业务主要面向 TIER1（车厂一级供应商）客户，公司也会参与整车厂部分研发项目合作。

**Q7、请介绍公司汽车电子 PCB 工厂南通三期项目的建设进展。**

公司南通三期项目已于今年四季度按期连线投产，目前处于投产早期阶段。

**Q8、请介绍公司数据中心业务发展情况。**

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场空间有待公司进一步开拓。伴随 5G 时代对信息传输速度及传输容量的需求提升，数据中心硬件也持续向高速、大容量的方向发展，其对 PCB 在高速材料应用、加

	<p>工密度及设计层数方面都有着更高要求，会推动产品价值量的提升。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021年12月10日